

Mech-Eye LSR XL-GL

원거리 초정밀 3D 산업용 카메라



- 초고해상도
- 광범위한 스캔 범위
- 탁월한 반사 방지 성능
- 환경광 간섭에도 뛰어난 인식력

500만 픽셀의 고해상도

첨단 광학 설계를 통해 Z축 방향의 포인트 클라우드 변동을 억제하며, 500만 픽셀의 고해상도로 원거리에서도 물체의 미세한 특징을 정확하게 포인트 클라우드로 표현합니다.

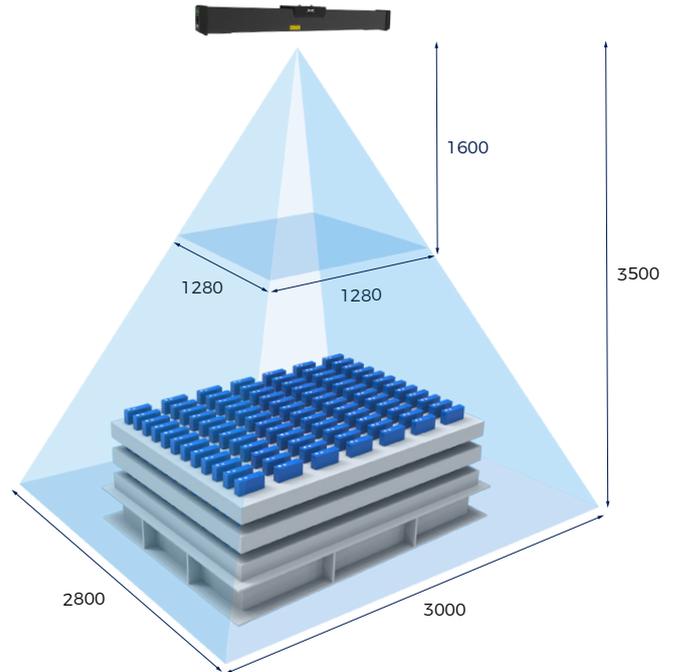
빛 반사 및 환경광에 대한 내성

자체 개발한 레이저 구조광 기술과 다중 스캔 모드를 통해 강한 주변광 및 고반사가 있는 상황에서도 고품질 이미징이 가능합니다.

원거리 애플리케이션을 위한 넓은 스캔 범위

넓은 시야와 깊은 피사계 심도로 더 넓은 스캔 범위에 대응할 수 있으며, 깊은 빈, 대형 파レット와 같은 원거리 측정 작업에서도 효과적으로 인식할 수 있습니다.

시야 (mm)



기술 사양

작업 거리: 1600-3500 mm

근거리 FOV: 1280 × 1280 mm @ 1.6 m

원거리 FOV: 3000 × 2800 mm @ 3.5 m

덱스 맵 해상도: 2448 × 2040

RGB 해상도: 4000 × 3000/2000 × 1500

단일점의 Z방향 반복 정밀도^[1]: 0.2 mm @ 3.0 m

VDI/VDE 측정 정밀도^[2]: 1.0 mm @ 3.0 m

캡처 시간: 0.6-1.1 s

치수: 942 × 88 × 116 mm

베이스라인: 800 mm

무게: 4.5 kg

작업 온도 범위: -10-45°C

통신 인터페이스: 기가비트 이더넷

광원: 레드 레이저(638 nm, Class 2)

입력: 24 V DC, 3.75 A

안전 및 전자파 적합성: CE/FCC/VCCI/KC/ISED/NRTL

보호 등급: IP65

냉각 방식: Passive

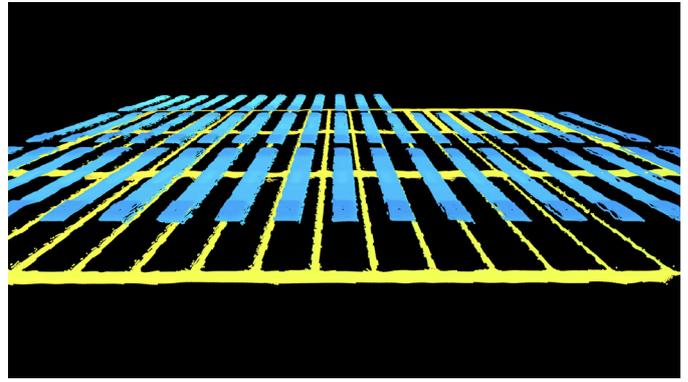
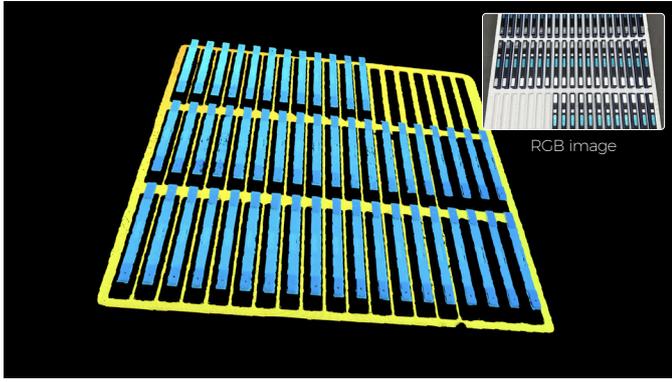
이미지 센서: 하이엔드 머신 비전을 위한 Sony CMOS

MTBF(평균 고장 간격): ≥ 100,000 시간

[1] 단일한 점의 Z 값에 대해 100 번 측정 후의 1 배 표준 편차이고, 측정 대상은 세라믹 플레이트입니다.

[2] AVDI/VDE 2634 Part II 표준을 기준으로 합니다.

완전하고 디테일한 포인트 클라우드



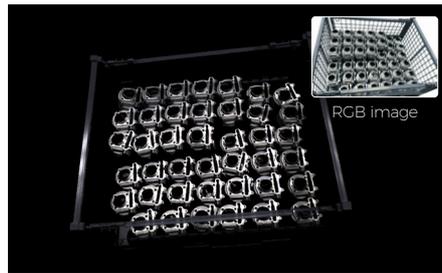
초광각 FOV와 깊은 피사계 심도를 통해 전체 레이어(1200 × 1200mm)에서 배터리 셀의 완전한 3D 포인트 클라우드를 캡처할 수 있습니다.

고해상도 및 고정밀도 이미지를 지원하여 3m 거리에서도 배터리 셀의 표면 특징을 상세하고 정확한 3D 데이터로 캡처할 수 있습니다.

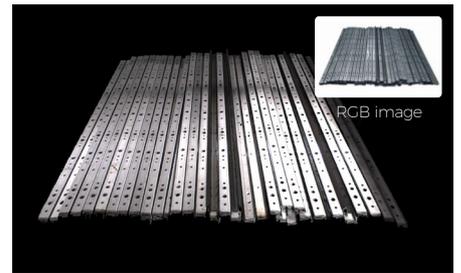
▲ Mech-Eye LSR XL-GL @ 3m. 높이에 따라 렌더링된 색상



고반사율의 브레이크 디스크



복잡한 구조의 실린더 블록



빛 반사가 있는 판금 부품

▲ Mech-Eye LSR XL-GL @ 3m

높은 정밀도가 요구되는 원거리 애플리케이션

자동차, 금속 및 가공, 물류, EV 배터리, 가전제품 등 다양한 산업 분야의 고정밀 빈 피킹, 머신 텐딩, 판금 분류 등 원거리 애플리케이션에 적합합니다.



깊은 빈에서 피킹



대형 물체 디팔레타이징



스탬핑 부품 언로드



대형 파트에서 피킹



판금 분류 및 언로드



대형 배터리 셀 언로드



Mech-Mind Robotics
 Business: info@mech-mind.net
 Marketing/PR: marketing@mech-mind.net
 Web: kr.mech-mind.com